



2018年7月23日

尊敬的汪尧进教授,

我们愉快地邀请您参加由中国物理学会电介质物理专业委员会和中国电子学会元件分会联合主办、广东工业大学承办、中山大学、华南理工大学、华南师范大学、清华大学深圳研究生院、无源元器件与集成省部产学研创新联盟协办的“第十七届全国电介质物理、材料与应用学术会议”暨“第十九届全国电子元件与材料学术大会”、以及“国际固态制冷材料和器件研讨会 (International Symposium on the Solid-State Cooling Materials and Devices) (ISSSCMD)”。此次会议定于2018年11月15-19日在广东省广州市大学城召开。

“全国电介质物理、材料与应用学术会议”是由中国物理学会电介质物理专业委员会主办的两年一届的学术会议，已经召开了十六届。“全国电子元件与材料学术大会”是中国电子学会元件分会主办的两年一度的全国性学术会议，已经召开了十八届。会议内容可参阅中文主页：<http://conf.scholarset.com/meeting/details?fid=71>。国际固态制冷材料和器件研讨会的详细内容可参阅英文主页 http://conf.scholarset.com/meeting/details?fid=72&locale=en_US。

全国电介质物理会议宗旨在增进电介质物理各个领域的专家、学者、学生以及产业界之间的学术交流与合作，推动我国电介质理论研究、新型电介质材料开发、电介质相关元器件应用研究开发的知识创新、技术创新以及产业发展。全国电子元件与材料学术大会旨在推动电子元件与材料的产学研结合，加强电子材料在元器件中的应用。国际固态制冷材料和器件研讨会旨在介绍世界固态制冷材料和器件方面的前沿研究，交流最新的学术成果，探讨制冷器件研究的最新进展和应用前景。

鉴于您在电介质材料和器件方面的较深造诣，特邀请您在百忙中拨冗出席，作邀请报告。

鲁圣国
广东工业大学材料与能源学院

李勃
清华大学深圳研究生院

章启明 (Qiming Zhang)
美国宾州州立大学材料研究所

